

NIKAFLEX®

ハロゲンフリーポリイミドフィルム基材カバーレイ用フィルム C-series
Halogen free polyimide film base coverlay型式
Model

C IS G

特徴 Characteristics

- **C IS G は耐マイグレーション性、高温時の屈曲性に優れる**
C IS G has better property not only anti-Ion-migration but also in flexural strength higher temperature.
- **はんだ耐熱性に優れ、フローソルダー工程に十分に耐える事ができますので広範囲の電子機器部品に使用されています**
Because of excellent resistance to solder temperature, it bears up against flow-soldering process and consequently suitable for a wide range of parts of high-class electronic equipment.
- **ハロゲン、アンチモン、リンフリー材料です**
C IS G doesn't contain halogen, antimony and phosphorus.

標準製品仕様

Specifications of standard Products

ベースフィルム厚さ (μm) Thickness of Base Film		12.5, 25
接着剤 Adhesive	種類 Classification	熱硬化性樹脂 Thermosetting Resin
	厚さ (μm) Thickness	15, 25, 35
接着剤面の保護材 Releasing Material on Adhesive Surface		剥離紙 Release Paper
標準サイズ (mm) Standard Size		500×Roll (100m)

UL Recognition (FILE No:E46785)

使用上の注意点 Caution

- 1 接着剤は半硬化となっておりますので、常温で放置しておきますと接着剤の硬化が急速に進行致しますので、保管は低温(5℃以下)、湿度 80%以下で管理して下さい。
Time and temperature rapidly promote a change from the semicured to the fully cured adhesive state, so keep C IS G at 5°C or below and at 80%RH or below.
- 2 保証期間は未開封の状態では製造後 4 カ月です。
Guaranteed period for C IS G before unpacked is 4 months after manufacture.
- 3 プレスパッドとして紙を使用する場合、紙中水分により接着剤が劣化し、接着剤とフィルムが剥離する場合がありますので使用前にご確認ください。
Moisture in press pads made of paper might make adhesiveness weaker and cause delamination of adhesive and polyimide film. If paper is used as press pads, be sure to check condition of press pads paper before using that.

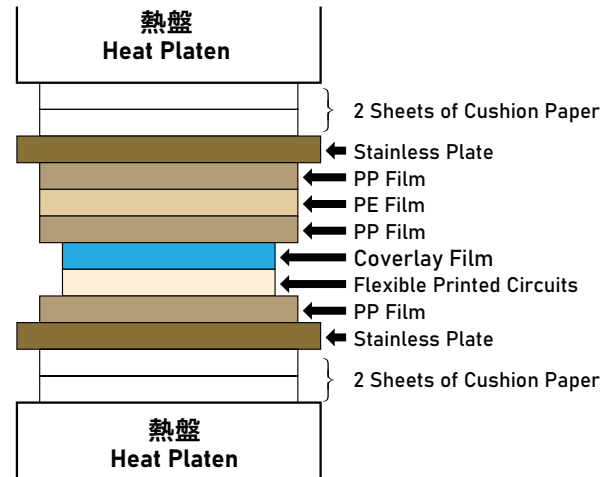
加工方法例

An Example of Processing Method

プレス手順 Procedures (Press-Bonding)

- 1 常温セット
Setting at room temp.
- 2 エアー抜き 3 回程度
Removing Air (about 3 times)
- 3 圧力セット(4MPa)
Apply pressure (4 MPa)
- 4 温度上昇
Temp. Elevation
- 5 100℃位になった時点で再度エアー抜き
Removing Air again at 100℃
- 6 圧力セット(4MPa)
Apply pressure (4 MPa)
- 7 140℃～160℃位になった時点で再度エアー抜き
Removing Air again at 140℃～160℃
- 8 160℃、4MPa、90分セット
Press-bonding at 160℃ under pressure of 4MPa for 90 min.
- 9 冷却
Cooling
- 10 取出し
Taking out

プレスセット例 Materials assembly for Press-bonding



性能表

Characteristic

ポリイミドフィルム 12.5 μm、接着剤厚さ 25 μm、C IS G 1225(NKB)
Model No. C IS G 1225 (NKB) (Polyimide Film 12.5μm, Adhesive 25μm)

試験項目 Test item	単位 Unit	処理条件 Treatment conditions	標準値 (平均) Standard Value	試験方法 Test Method
接着剤フロー Resin Flow	mm	A	0.18	弊社方式 Our Standard
表面抵抗率 Surface Resistivity	Ω	C-96/20/65	4.0×10 ⁹	JIS C 6481
		+C-96/40/90	3.0×10 ⁸	
体積抵抗率 Volume Resistivity	MΩ-cm	C-96/20/65	2.0×10 ⁹	JIS C 6471
		+C-96/40/90	1.0×10 ⁹	
引きはがし強さ Peel Strength	N/mm	A	0.5	JPCA-BM-02
はんだ耐熱性 Solder Heat Resistance	—	280℃/10sec.	異常なし No change in appearance	IPC-FC-232B
耐熱性 Heat Resistance	—	E-24/130	異常なし No change in appearance	JIS C 6481
耐薬品性 Chemical Resistance	—	23℃/10min.	異常なし No change in appearance	JPCA-BM-02

- NOTE (1) 接着剤フロー、引きはがし強さ、はんだ耐熱性、耐熱性、耐薬品性は電解銅箔 35 μm (1 オンス) の光沢面と接着剤面を合わせプレスした値です。
Values of resin flow, peel strength, solder heat resistance and chemical resistance are those of laminate obtained by press-bonding the untreated side of electrolytic copper foil (35 μm, 1 ounce) with C IS G 1225 (NKB).
- (2) プレス条件/温度: 160℃、時間: 90 分、成形圧力: 4MPa
Press conditions: 160° C/90min./molding pressure 4MPa